

宁波PCB基板植球设备

生成日期: 2025-10-23

基板植球补球一体机适用于BGA、WLCSP、PCB板等各类器件锡球植入，设备的使用能够提高工作效率。基板植球补球一体机特性：1. 可以对应多种PCB、BGA基板的微锡球植球，检查及修补，可选择离线或在线方式。2. 从上料到下料可实现全自动作业。3. 各个工序同时作业，作业效率大幅提高。4. 根据客户需要，可和其他设备连接组成产线。5. 可对应不同尺寸，厚度的基板。6. SECS/GEM、OHT、AGV可选。设备的使用可以高效率的刷胶和植球，刷球的毛刷有高效率植球的同时，还可以延缓锡球的氧化，不损伤锡球。基板植球机采用了球配列技术和极力缩短真空路径的搭载头。宁波PCB基板植球设备

BGA基板植球机植球后，用图像处理系统检查基板，把不合格的基板放进废料盒，合格品进入下一道工序——回流炉。BGA基板植球机可以分为基板上料装置、焊球供给、针转写/印刷、植球和基板传送部分等子系统。爱立发的设备利用网板，可以高效率的刷胶和植球，刷球的毛刷有，高效率植球的同时，还可以延缓锡球的氧化，不损伤锡球。还可以根据需要配置检查与修补，与其他设备如回流炉连接，组成产线自动化作业。经过修补的基板，效果可以达到100%，爱立发的设备利用网板可以高效率的植球和刷胶。宁波PCB基板植球设备基板植球机的植球工艺和关键技术的研究对于设备的研制十分必要。

BGA基板植球机的有什么使用注意事项？BGA基板植球机的注意事项：需要采用正确的方法来进行使用。BGA基板植球机是采取针转写方式高效克服基板弯曲的问题。是采用球配列技术和极力缩短真空路径的搭载头，能实现锡球的无误安定搭载。BGA基板植球机使用新型的自动供球和吸取方式，提高供球盘中球的利用率，从而降低焊球的氧化劣化风险。BGA基板植球机采用精密的传动机构，结合先进的图像处理系统和传感技术，能实现转写、搭载时的精密定位和自动位置补正。植球机是封装测试领域的一种关键设备。

近年来由于互联网、人工智能时代的到来，机械及行业设备遭受多次冲击，传统产业正在朝着信息化、集成化等方向发展。业内人士表示，随着工业机械行业的成熟发展，未来将会有更多细分领域飞快成长。植球机在生活中是很常见的，那么植球机的工艺流程是怎么样的呢？植球机的工艺流程主要如下：(1) 上料：手动将摆满芯片的精密承载托盘定位在植球机工作平台上，由Y向直线模组带动托盘定位到工作位置，托盘底部真空检测以确保芯片位置摆正。(2) 供胶：刮胶机构中的双刮刀来回运动，抹平供胶盒中的助焊剂，分厘卡调整刮刀升降高效控制刮胶量。(3) 针转写：转印头由X向直线模组定位到刮胶机构，转印针蘸胶后运动到托盘处，然后Z向直线模组带动转印头下降，在芯片上印助焊剂。基板植球机的定位精度高。

植球机的主要构件包括超声电源、换能器、送线机构、劈头、温度可控的夹具等。植球机的应用可以提高生产效率，控制品质，节省成本。植球机适用于各种有铅和无铅BGA芯片植球，使用范围：适用于各种有铅和无铅BGA芯片植球，锡球大小0.05~0.3mm。敝司的设备利用网板，可以高效的刷胶和植球，刷球的毛刷有独自的技术，能高效植球的同时，还可以延缓锡球的氧化，不损伤锡球，独自的吹氮气锡球供球治具，可以有效控制锡球的供给，不产生浪费，能降低客户的运营成本。基板植球机采用了精密的传动机构。宁波PCB基板植球设备

基板植球机在工业中是很常见的。宁波PCB基板植球设备

BGA基板植球机具备什么特点□**BGA**基板植球机设备配备植球完成品的视觉自动检查和分类功能，开发的图像处理算法能够快速高效的检测出多球、少球、缺陷、错位等不良品□**BGA**基板植球机的人机界面友好，便于操作□**BGA**基板植球机是采用的球配列技术和极力缩短真空路径的搭载头，能实现锡球的无误安定搭载□**BGA**基板植球机使用新型的自动供球和吸取方式，提高供球盘中球的利用率，从而降低焊球的氧化劣化风险□**BGA**基板植球机采用精密的传动机构，结合先进的图像处理系统和传感技术，能实现转写、搭载时的精密定位和自动位置补正。宁波**PCB**基板植球设备